

标题：光刻机、先进封装概念，一季度业绩回暖，机构进入前十大流通股东名单

摘要：股东户数最近 2 个季度连续减少。

作者：市值风云 App：韦三甲

公司近期看点：

- 1、行业复苏，公司一季度净利润同比增长 92.7%；
- 2、杠杆资金开始活跃，“北向资金”流入。

以下为付费部分（不可见）

一、公司简介及业绩情况

晶方科技专注于传感器领域的封装测试业务，拥有多样化的先进封装技术，同时具备 8 英寸、12 英寸晶圆级芯片尺寸封装技术规模量产封装线，涵盖晶圆级到芯片级的一站式综合封装服务能力。

封装产品主要包括影像传感器芯片、生物身份识别芯片等，该等产品广泛应用于手机、安防监控、身份识别、汽车电子、3D 传感等电子领域。

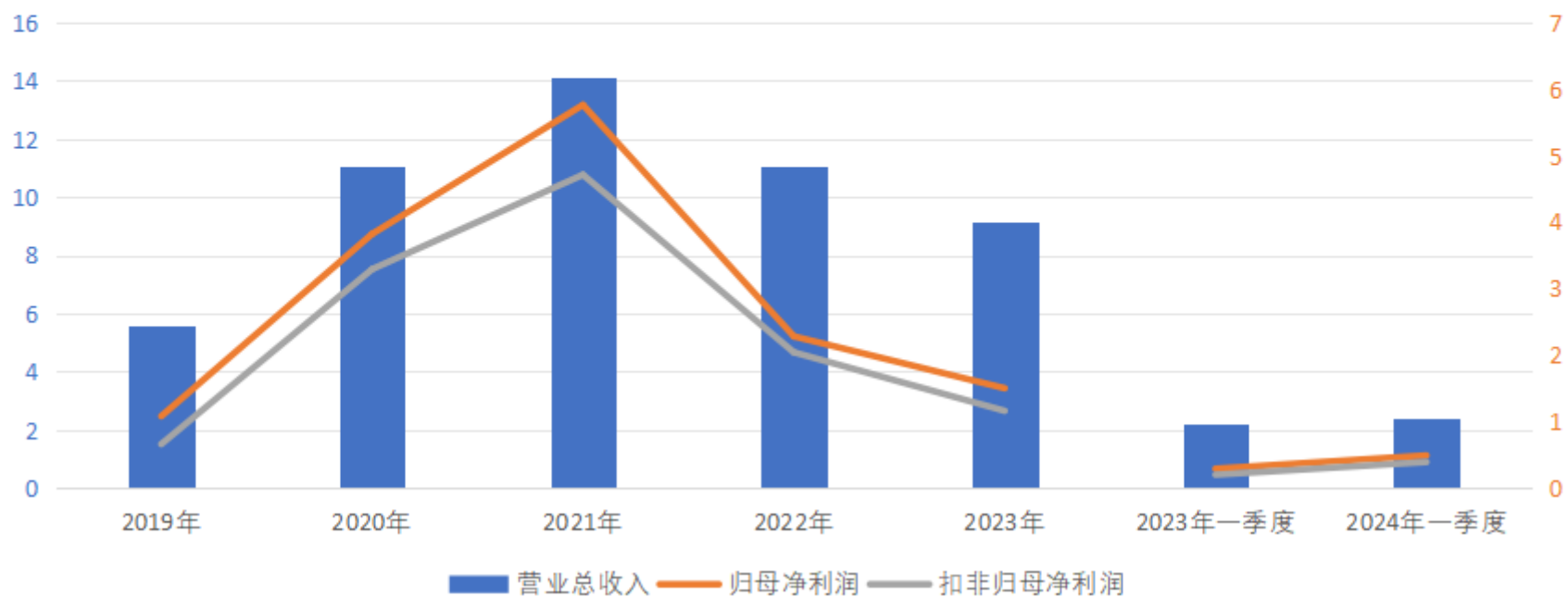
2023 年下游需求不振，导致半导体行业陷入下滑趋势。但是年末开始，半导体开始逐渐呈现复苏趋势，今年一季度全球半导体销售总

额同比增长 15.2%。

公司 2023 年营收同比下滑 17.4%，扣非归母净利润同比下滑 43.3%。今年一季度业绩大幅回暖，营收同比增长 7.9%，扣非归母净利润同比增长 92.7%。

	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2023年一季度	2024年一季度
营业总收入	5.60	11.04	14.11	11.06	9.13	2.23	2.41
归母净利润	1.08	3.82	5.76	2.28	1.50	0.29	0.49
扣非归母净利润	0.66	3.29	4.71	2.04	1.16	0.20	0.39

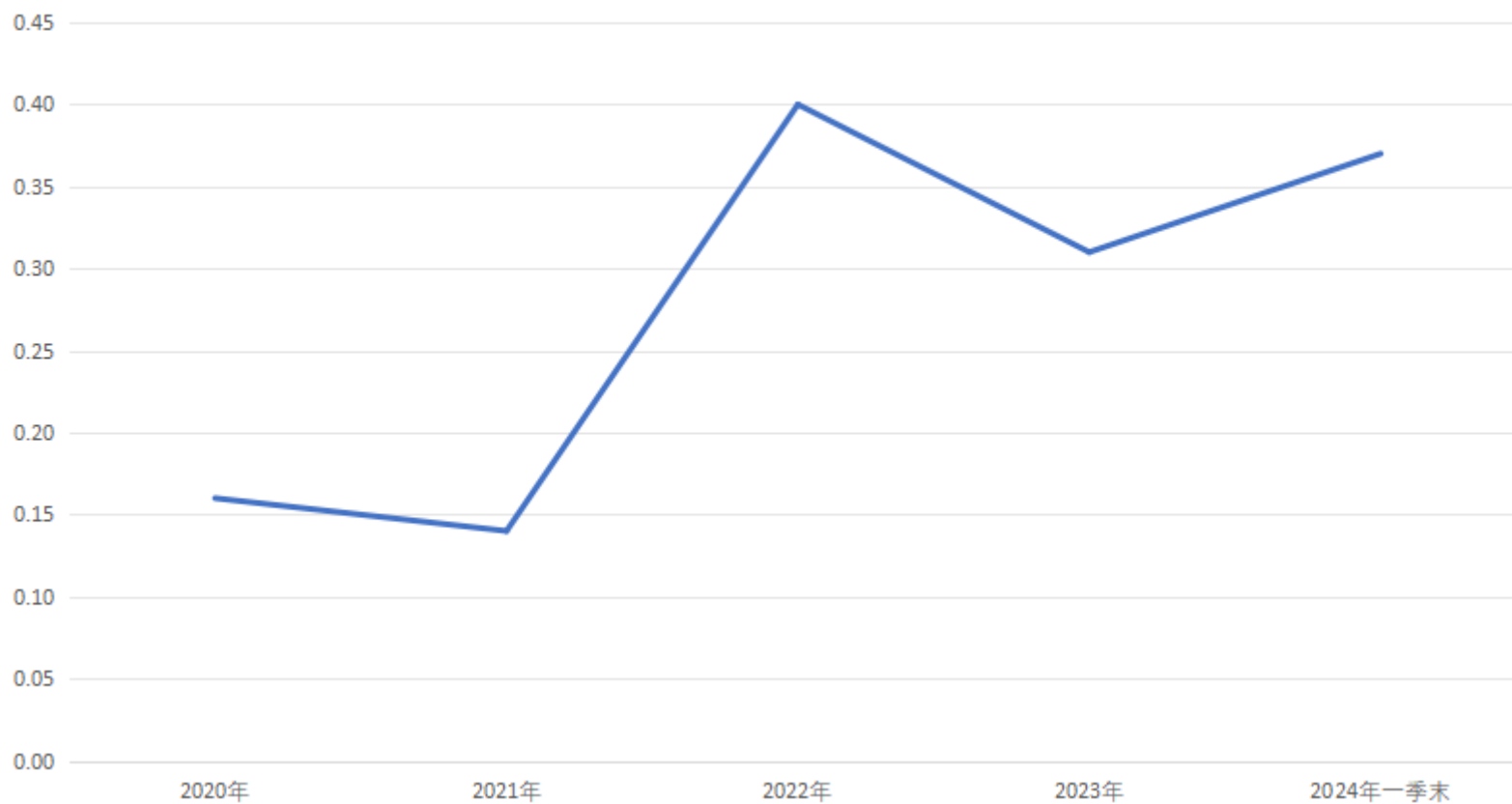
晶方科技业绩（亿元）



(来源: Choice 金融终端, 制图: 市值风云 APP)

一季度末，公司在手订单量回升，合同负债金额相较 2023 年末增长。

合同负债(亿元)



(来源: Choice 金融终端, 制图: 市值风云 APP)

二、涉及概念

- 1、光刻机概念：公司下属荷兰 ANTERYON 公司服务国际领先光刻机厂商，部分产品运用于光刻机部件。
- 2、先进封装概念：TSV，微凸点，硅基转接板，异构集成技术等是 HBM 集成应用中使用的系列关键技术，公司专注于晶圆级 TSV 等相关先进封装技术，目前正在积极关注，不断拓展提升自身技术工艺能力。
- 3、汽车芯片概念：全球最大的 CIS 芯片封测厂商，在汽车摄像头应用领域已有多年布局和拓展，已经开始导入量产。
- 4、华为概念：公司业务处于产业链的封装服务环节，主要客户为芯片设计公司，华为等厂家为公司封装芯片的终端用户之一。

三、事件催化

国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立，法定代表人为张新，注册资本 3440 亿人民币。此次六大行全部出手，合计认缴出资 1140 亿元，是三期基金的新增 LP 主力。

现阶段半导体软件、主要设备、材料、及基础晶圆厂生态已经初步构成，预计未来国家大基金三期的主要投资方向将重点发力于先进晶圆制造、先进封装以及关键卡脖子设备、零部件及 AI 相关芯片研发、量产等方向。

今年以来半导体行业呈现复苏态势，美国半导体行业协会（SIA）最新数据显示，2024 年第一季度全球半导体销售总额为 1377 亿美元，同比增长 15.2%，环比下降 5.7%。

四、市场行为

一季度末，有 4 家机构新进入公司前十大流通股东名单，其中包括一支公募产品、一支私募产品和中信证券。另外，公司的前十大流通股东中还有国联安基金和景顺长城基金的身影。

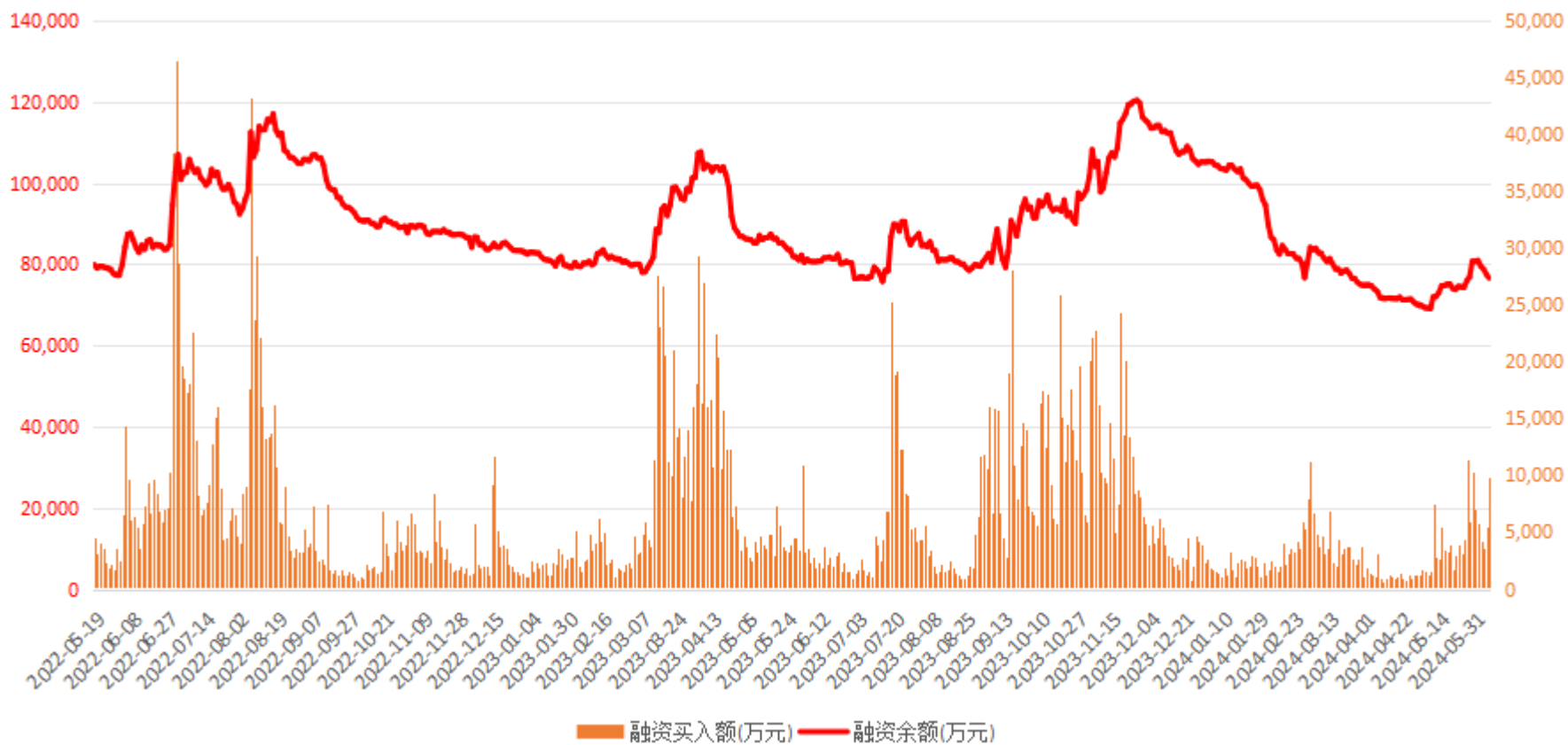
2024—季报

股东名称	股东性质	持股数量(股)	占总股本比例(%)	占无限售流通股比例(%)	较上期持股变动数(股)	占总股本比例变动(%)
中新苏州工业园区创业投资有限公司	投资公司	115,849,766	17.75	17.76	不变	0.0000
香港中央结算有限公司	其它	14,343,587	2.20	2.20	7,939,113 ↑	1.2165 ↑
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指...	证券投资基金	8,531,834	1.31	1.31	-296,100 ↓	-0.0454 ↓
上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城电...	证券投资基金	4,371,964	0.67	0.67	-1,371,500 ↓	-0.2102 ↓
孙小明	个人	4,022,464	0.62	0.62	不变	0.0000
上海韦尔半导体股份有限公司	其它	3,320,075	0.51	0.51	不变	0.0000
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易...	证券投资基金	2,905,351	0.45	0.45	新进	-
上海国盛资本管理有限公司-上海国企改革发...	私募基金	2,656,061	0.41	0.41	新进	-
中信证券股份有限公司	证券公司	2,190,169	0.34	0.34	新进	-
苏州工业园区厚睿企业管理咨询有限公司	其它	1,831,405	0.28	0.28	新进	-
合计		160,022,676	24.52	24.54		

(来源: Choice 金融终端)

5月融资买入额出现活跃迹象, 融资买入额小幅增长。不过融资买入规模相较于去年8-10月份还处于较低水平。

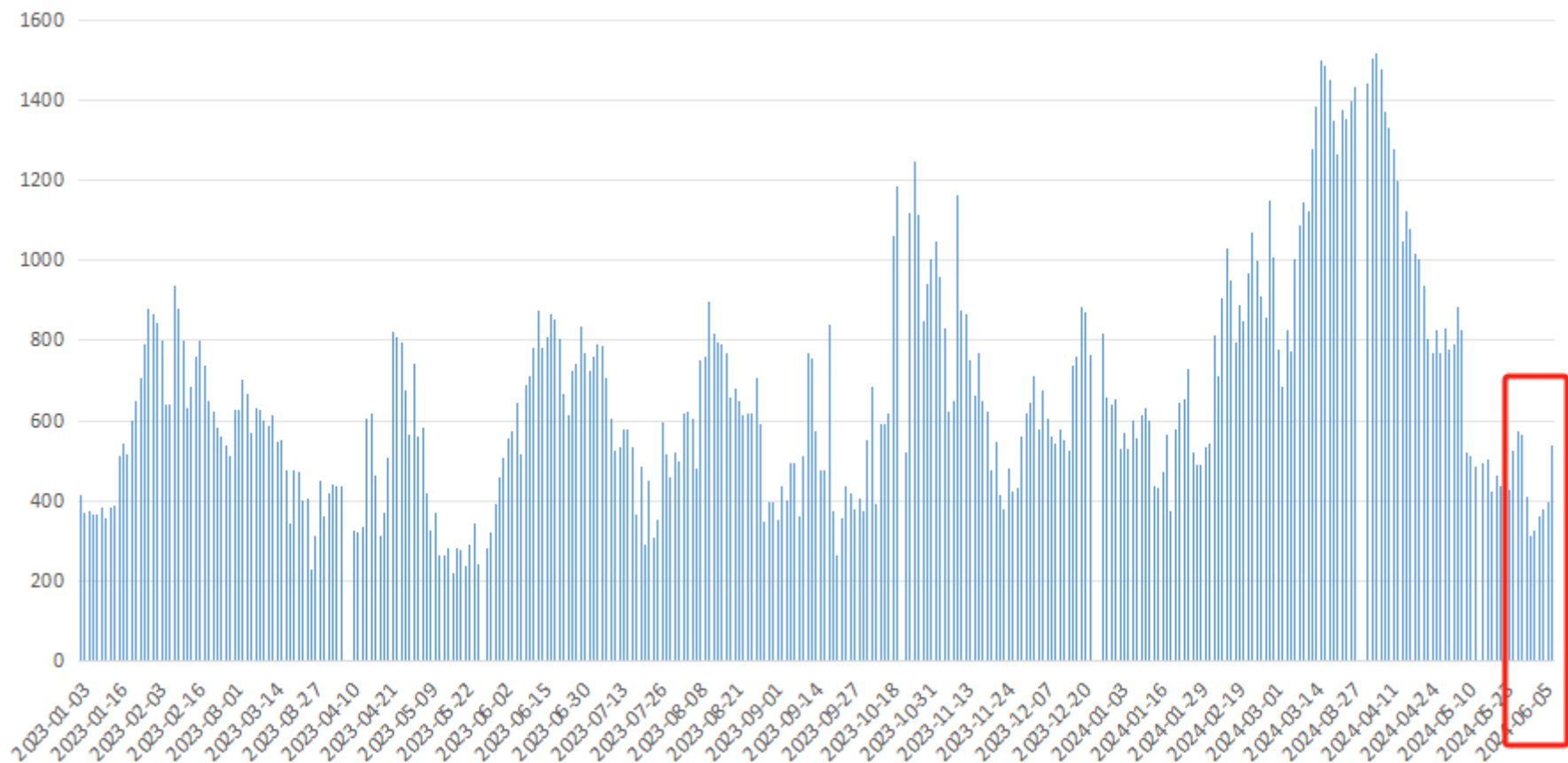
融资买入晶方科技情况



(来源: Choice 金融终端, 制图: 市值风云 APP)

北向资金于近期开始加仓。

沪股通持股数量(万股)



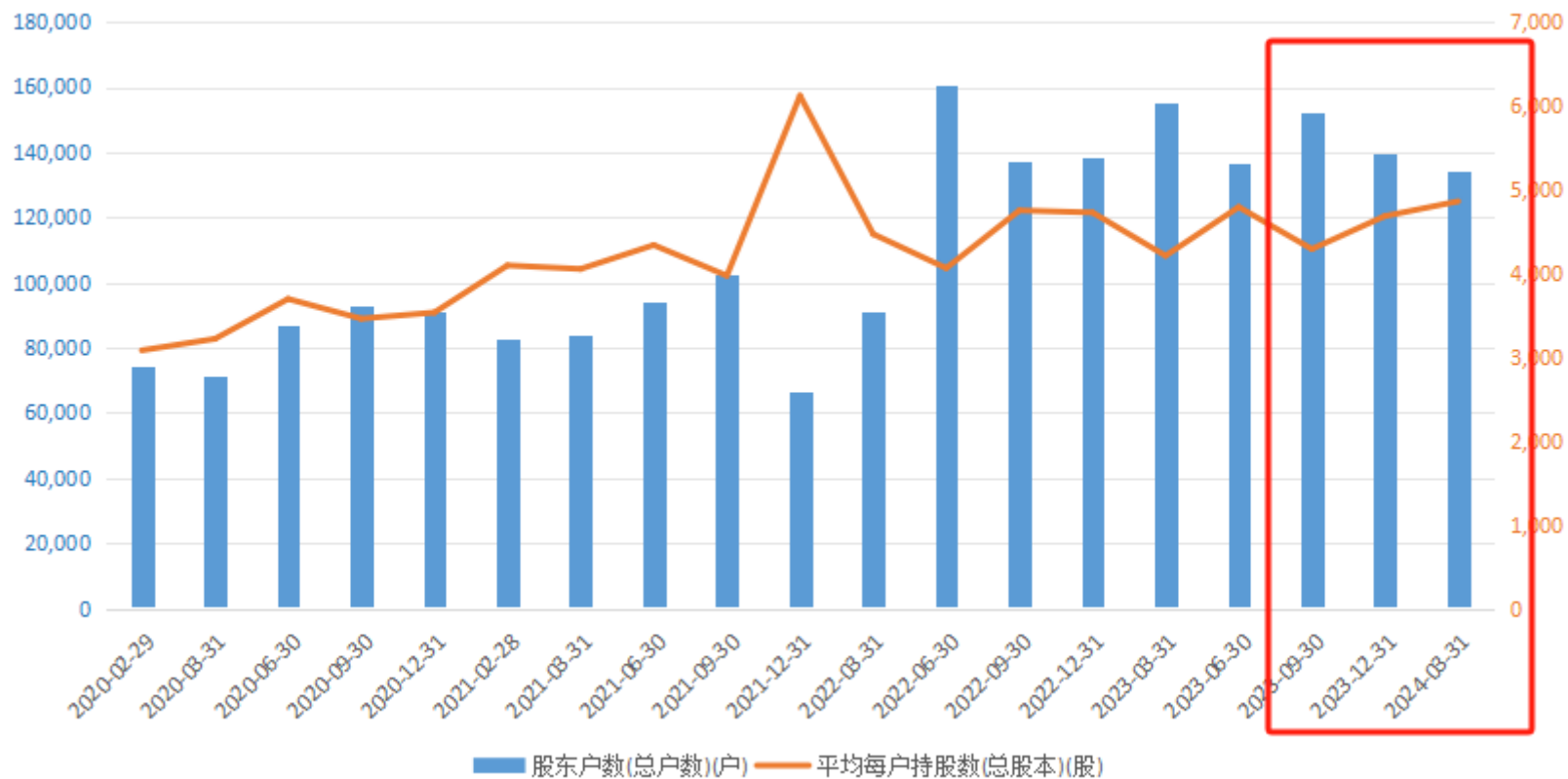
(来源: Choice 金融终端, 制图: 市值风云 APP)

公司近期没有限售股解禁，也没有减持计划在实施中。

目前有一项回购正在实施中，公司计划用 1500-2500 万元收购不超过 96.41 万股公司的股票，回购价格上限为 25.93 元/股。

股东户数自 2023 年三季度末开始呈现连续收缩态势，一季度末相较去年三季度末股东户数减少 11.7%，筹码集中度提升。

晶方科技股东户数变动情况



(来源: Choice 金融终端, 制图: 市值风云 APP)